

## 合肥晶合集成电路股份有限公司

### 2023 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

##### （二）业绩预告情况

1、经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现营业收入 706,000.00 万元到 741,300.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少 263,794.86 万元到 299,094.86 万元，同比下降 26.25%到 29.76%。

2、预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,000.00 万元到 25,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少 279,043.08 万元到 287,543.08 万元，同比下降 91.63%到 94.42%。

3、预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,600.00 万元到 5,400.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少 282,434.64 万元到 284,234.64 万元，同比下降 98.12%到 98.75%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

#### 二、上年同期业绩情况

2022 年公司实现营业收入 1,005,094.86 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 304,543.08 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 287,834.64 万元。

### 三、本期业绩变化的主要原因

#### （一）主营业务影响

自 2022 年以来，全球集成电路行业进入下行周期，智能手机、笔记本电脑等消费电子市场下滑，市场整体需求放缓，供应链持续调整库存，导致全球晶圆代工面临不同程度的产能利用率下降及营收衰退，而公司折旧、摊销等固定成本较高，导致公司营业收入和产品毛利水平同比下降。

#### （二）期间费用影响

1、报告期内，公司始终高度重视研发和技术创新，依靠成熟制程的制造经验，以面板显示驱动芯片、CMOS 图像传感器芯片、电源管理芯片、微控制器芯片为主轴，积极拓展逻辑等技术平台，持续加大研发投入，相应的研发设备折旧、无形资产摊销及研究测试费用等同比增加。

2、受汇率波动影响，财务费用较上年同期增加。

### 四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

### 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日